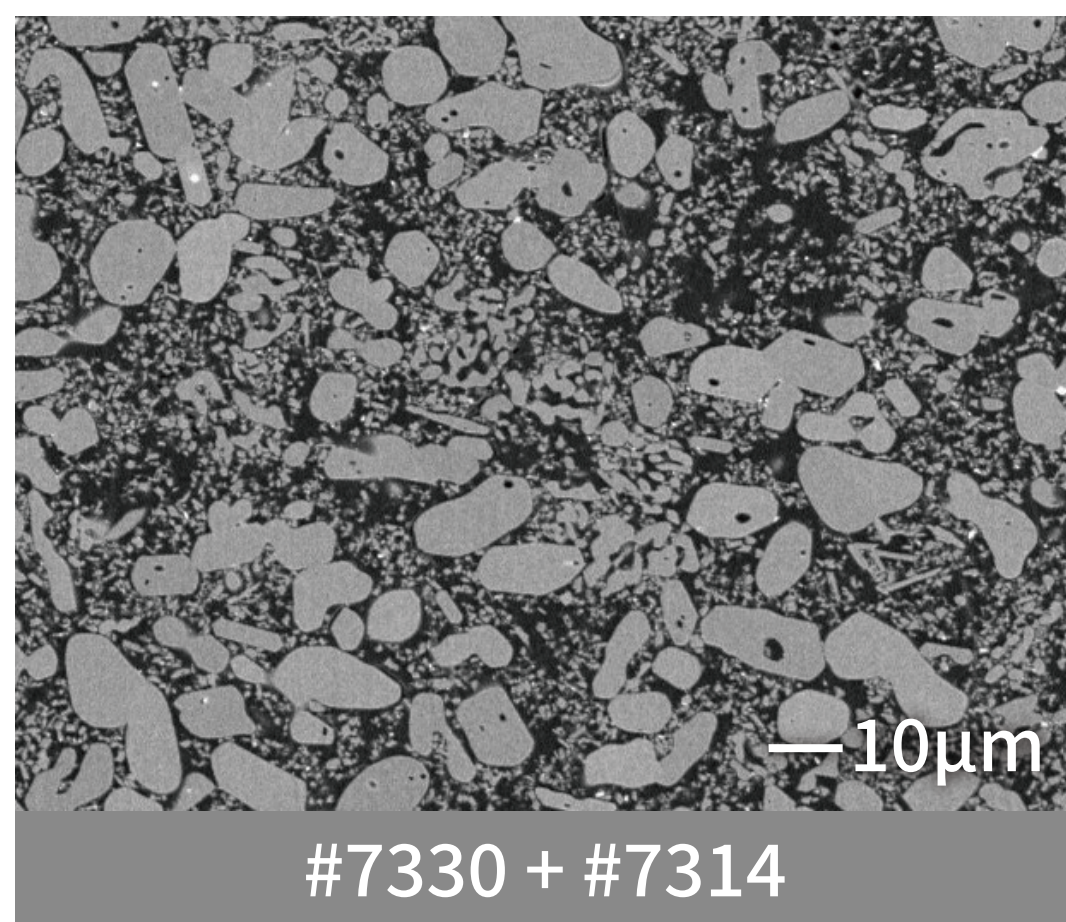
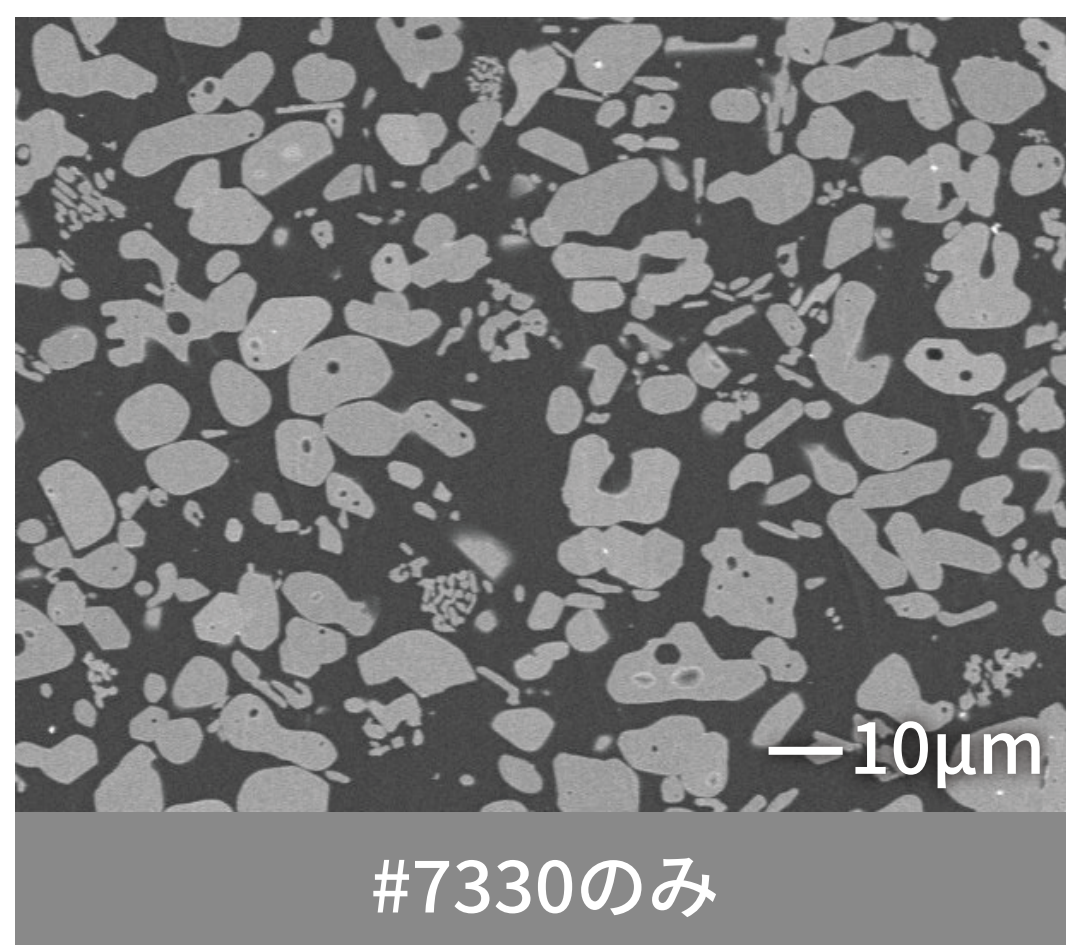


開発品ラインナップ

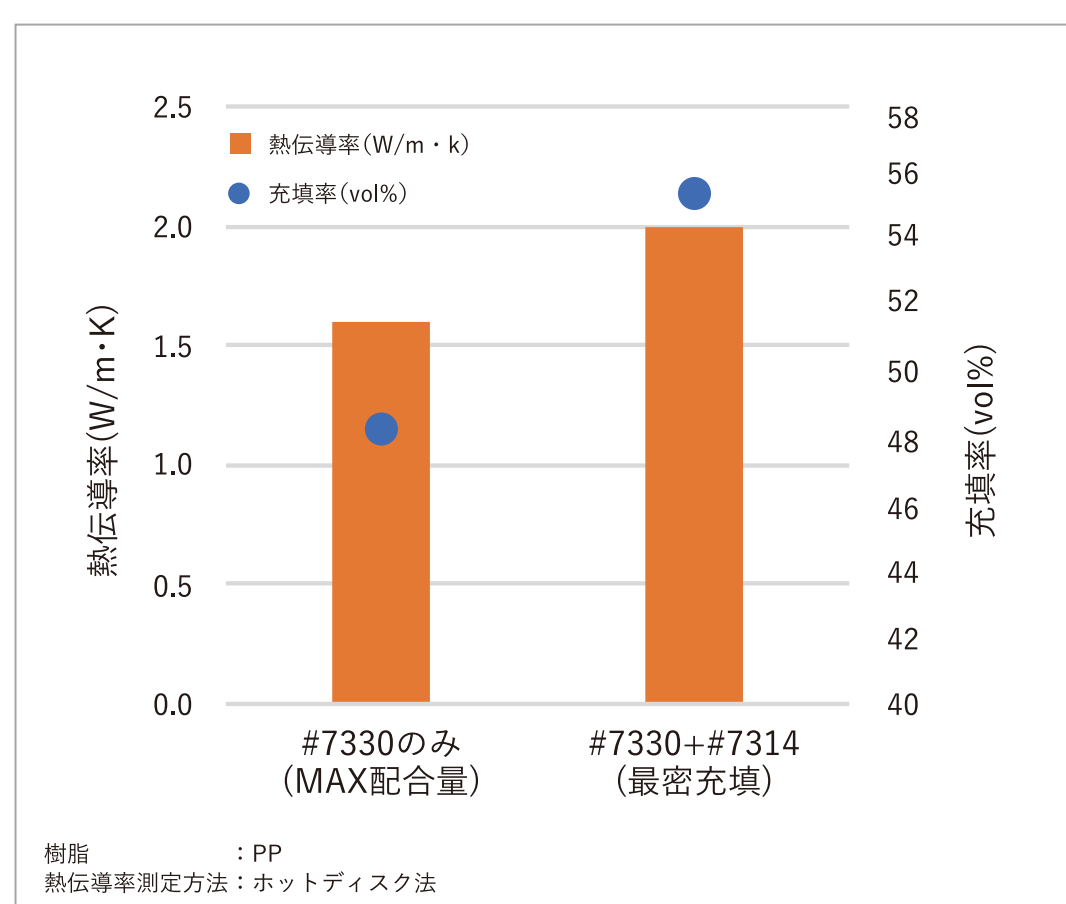
ダイピロキサイドシリーズ

ダイピロキサイド #7314

充填性の限界を超える
サブミクロンフィラー



最密充填による熱伝導率の向上



- 最密充填によってさらなる高熱伝導率を実現します

貴社の樹脂に最適化します

- 湿式での緻密な表面処理により、樹脂との相溶性を高めることが可能です
- 樹脂種に合わせた処理品が提案できますのでご相談ください

大日精化工業株式会社 / Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

顔料事業部 開発課

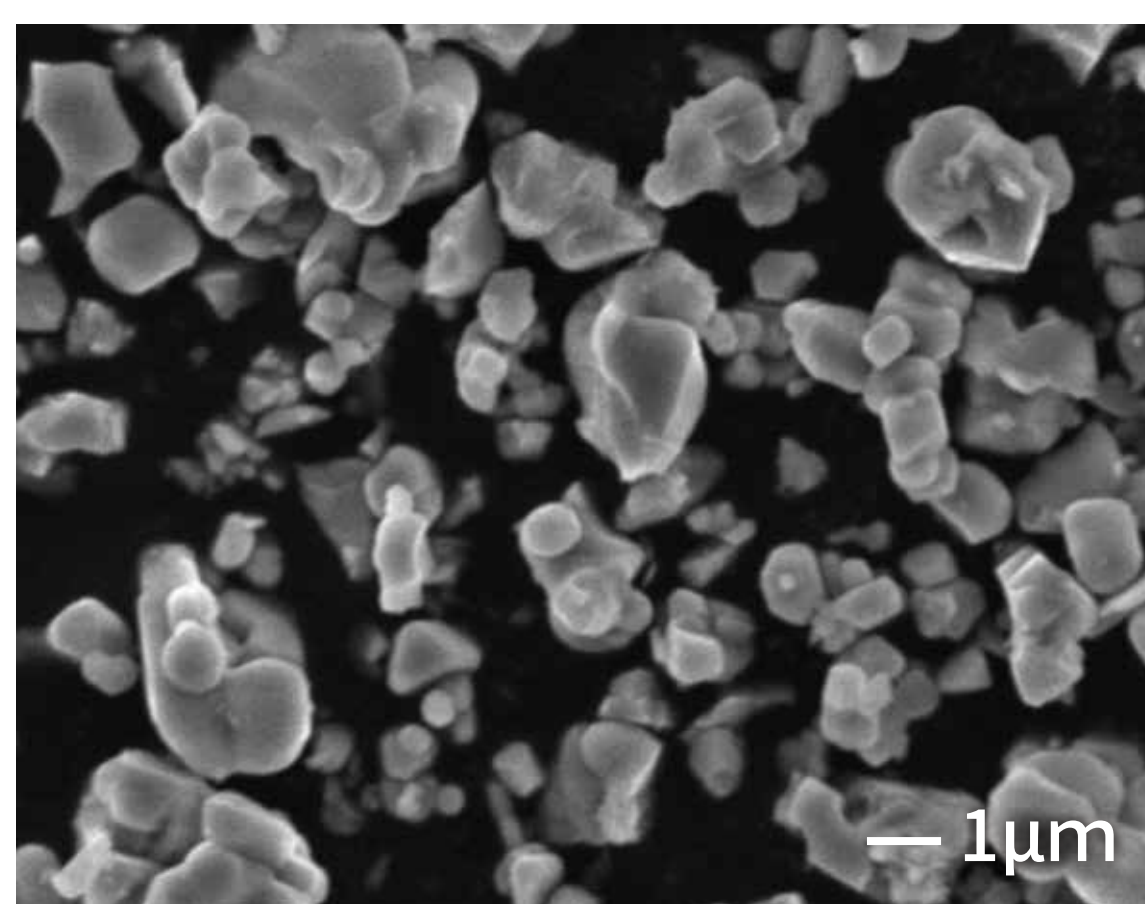
Tel: 03-3662-8032 e-mail: dns-pig@daicolor.co.jp

※本物性データは、所定の試験方法における当社評価値であり、実際の適用結果を保証するものではありません。

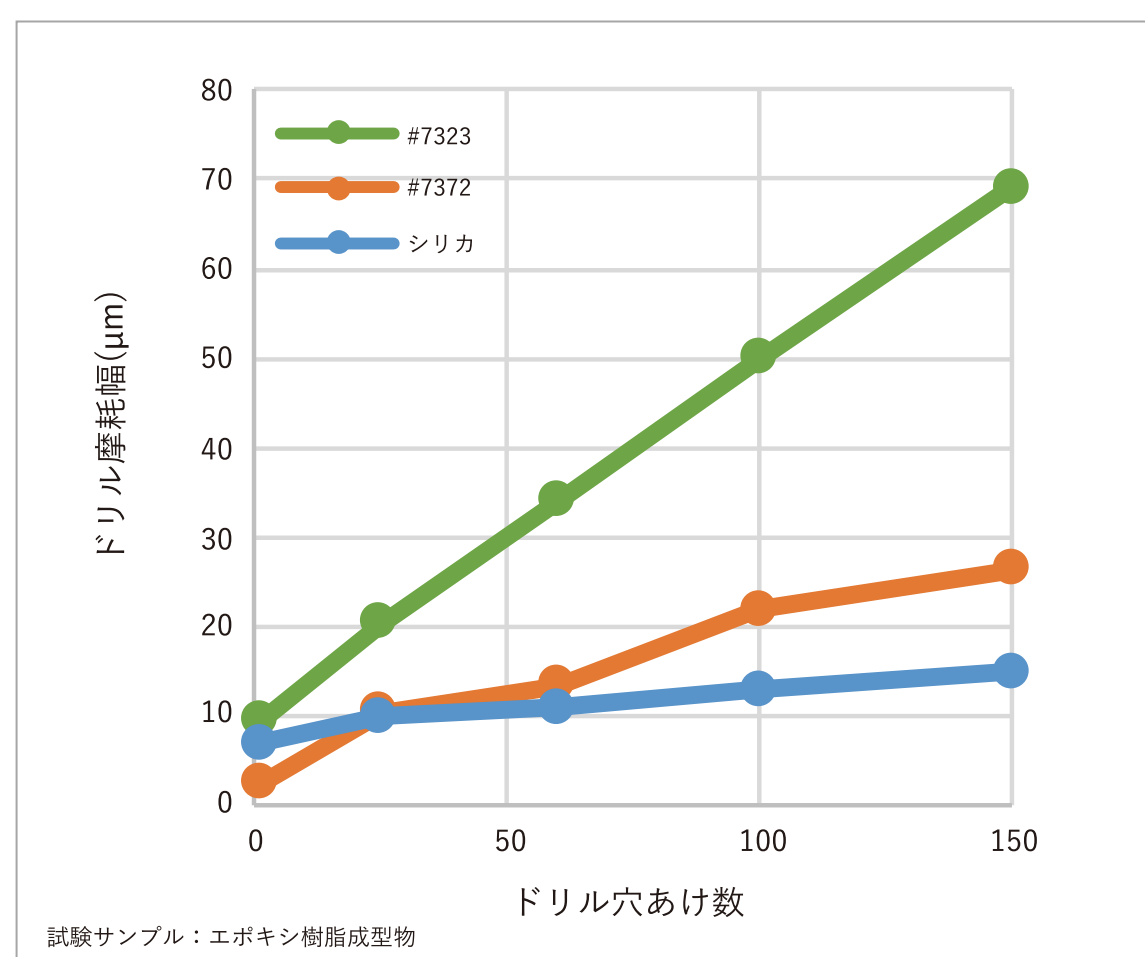
ダイピロキサイド #7372

低摩耗の新たな選択肢

- 亜鉛複合化による低摩耗性
- 優れた耐水・耐薬品性
- 高充填性



各種フィラーのドリル摩耗

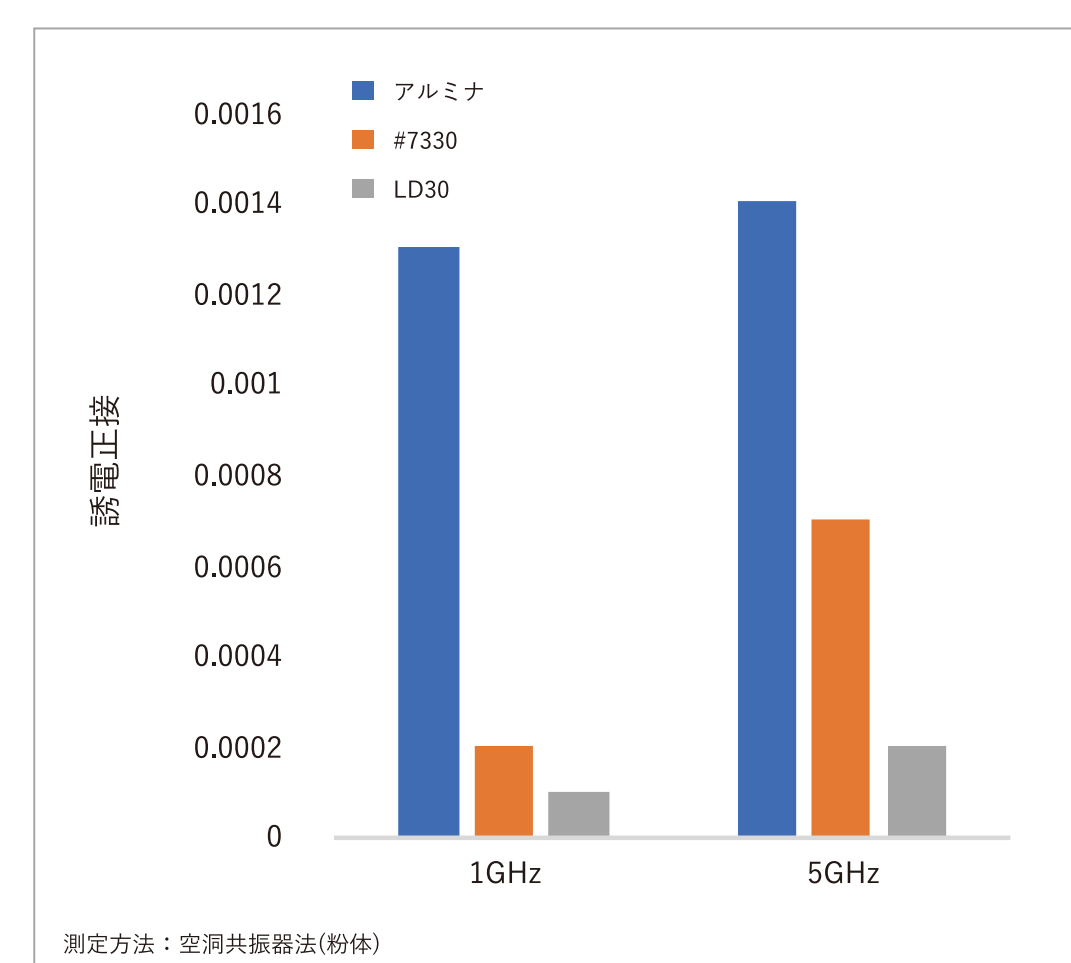


- 用途・プロセスに合わせた最適な低摩耗性フィラーをご提案します

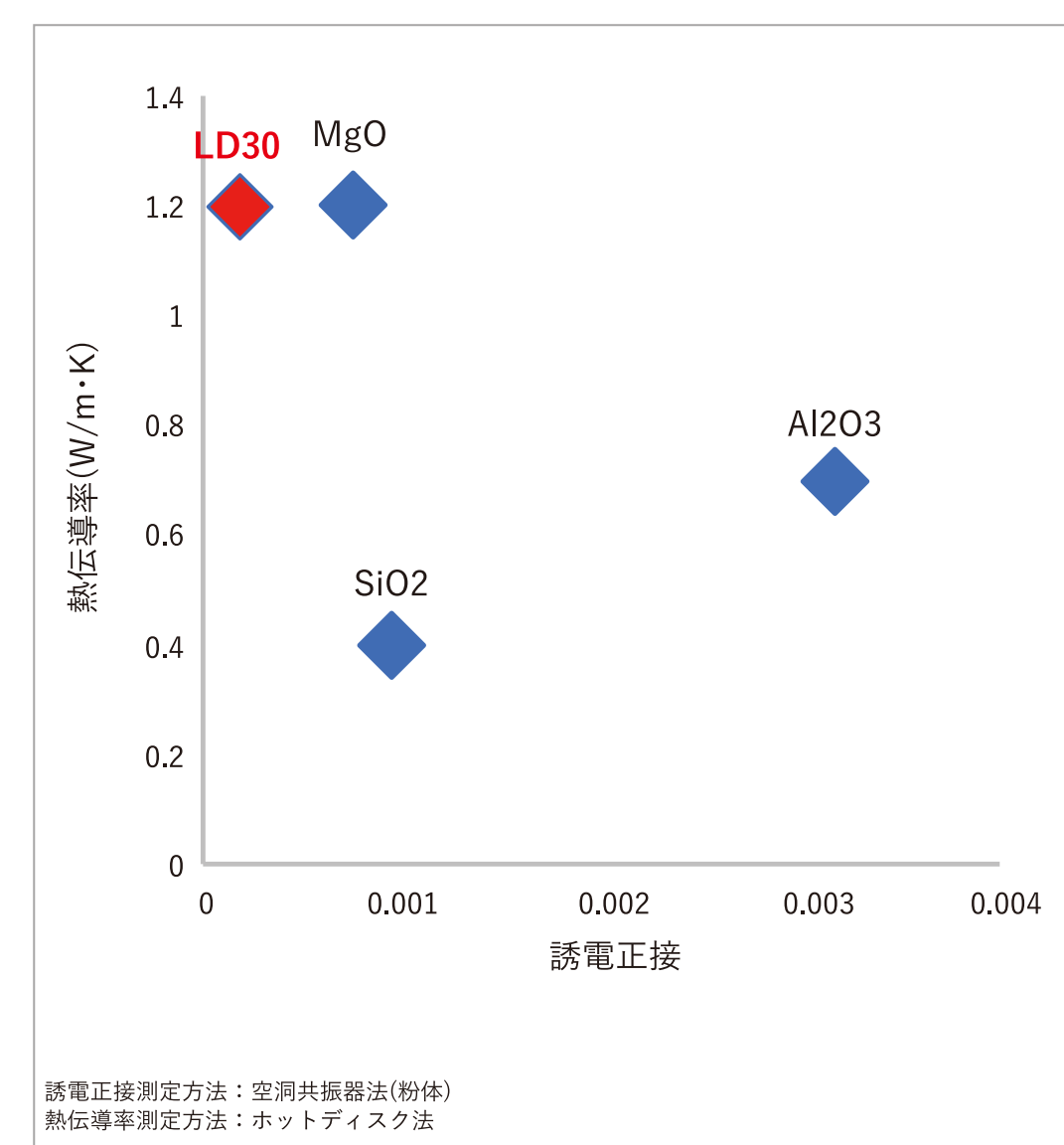
ダイピロキサイド LD30

高速通信時代の熱対策

各種フィラーの誘電正接



各種フィラーの誘電正接と熱伝導率



- 放熱と誘電損失の2つの課題を1つのフィラーで解決します